

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者： 博时基金、承珞资本、Inatai Foundation、君成投资、水璞私募、海金投资、第五公理、泰信基金、诺安基金、东吴基金、邮储银行、国泰基金、大成基金、长信基金、明河投资、人保资产、拾贝投资、南土资管、长城财富、中新融创、理成资产、红石榴、中信股衍、贵源投资、明世伙伴、创富兆业、上银基金、海通证券、国联证券、华福证券、西南证券、平安证券、金浦投资、华泰证券、信达澳亚、华泰资管、中银基金、世诚投资、弘毅投资、人保养老、白犀资产、中邮基金
时间	2024 年 4 月 28 日-2024 年 4 月 29 日
地点	线上及网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：张兵 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 财务总监：吕敏 独立董事：李挺 保荐代表人：刘伟 证券事务代表：徐雯

投资者关系活动主要内容介绍

## 一、公司管理层介绍 2023 年度及 2024 年一季度经营情况

**1、公司整体经营情况：**2023 年，公司实现营业收入 3.6 亿元左右，同比增长 11.2%，主要是国内半导体行业总体呈现出复苏趋势，下游厂商的需求回暖，同时公司在先进封装，晶圆领域的市场份额也持续提升，这使我们的收入表现出良好的增长趋势。另外，得益于产品结构优化调整，电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等高毛利产品收入占比的提高，带动公司毛利率同比提高 3.84 个百分点，扣除非经常性损益的净利润同比增长 88.60%，大幅高于收入的增长幅度。归母净利润 3,265.73 万元，同比增长 40.25%。

**2、主营业务分产品的情况：**2023 年度，公司电镀液及配套试剂营收 1.79 亿元，占主营业务收入比例 51.85%，光刻胶及配套试剂营收 6,877.32 万元，占比近 20%，其中，光刻胶 2023 年销售收入为 1,200.34 万元，同比增长 38.65%，电镀配套材料 9,474.39 万元，占比 27.47%。

### 3、公司产品进展情况：

在电镀液及配套试剂方面：（1）晶圆制造铜制程用清洗液，实现小批量供应（2）晶圆制造 28nm 大马士革铜互连工艺镀铜添加剂在中试阶段（3）晶圆制造 14nm 以下制程的超高纯硫酸钴在客户验证阶段（4）先进封装方面的电镀铜添加剂，电镀锡银添加剂都在稳定性验证阶段。

在光刻胶及配套试剂方面：公司光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进封装和半导体显示等应用领域，（1）在晶圆制造领域，公司的 i 线光刻胶已经在晶圆厂小量产。另外，公司的 PSPI 光刻胶目前在主力晶圆厂验证测试中。（2）在先进封装领域，公司的先进封装负性光刻胶已经在主要封装厂实现量产，目前处于量产放大阶段。（3）半导体显示领域，公司 OLED 光刻胶（全膜层）目前在京东方验证中。（4）公司先进封装光刻胶配套试剂已经是国内先进封装厂的主力供应商之一。

**4、2024 年第一季度经营情况：**公司 2024 年第一季度营收 8,185.97 万元，同比增长 14.22%；归母净利润 751.01 万元，同比增长 112.28%，主要是因为营收增长，政府补助和资金管理收益的增长。

## 二、问答交流环节

**问题一：请介绍下目前在先进封装领域的布局状况，以及适用 HBM 封装的产品情况。**

回答：公司在先进封装领域布局有电镀液、光刻胶及配套试剂产品。其中在先进封装电镀领域，公司先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂处于稳定性验证阶段。在先进封装光刻领域，公司自研先进封装负性光刻胶已实现批量供应，成功打破国外垄断。公司光刻胶配套试剂主要应用于先进封装领域，公司是国内先进封装光刻胶配套试剂产品主力供应商，主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。公司现有量产产品“先进封装负性光刻胶”、“电镀铜基液”、“铜钛蚀刻液”以及客户认证中的“电镀锡银添加剂”等产品可以用于 HBM 封装。

**问题二：据我所知，光刻胶分为 PCB 光刻胶、显示面板光刻胶、半导体光刻胶。制作工艺 PCB 光刻胶最简单，半导体光刻胶最难国产化率也最低。请问公司研发的光刻胶及配套试剂属于哪一类，打破国外垄断的有哪些，目前的应用情况如何。**

回答：公司以先进封装负性光刻胶、OLED 光刻胶以及晶圆用 PSPI 等特色工艺光刻胶为突破口，光刻胶产品覆盖晶圆制造、先进封装及半导体显示等应用领域。目前，先进封装负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应；OLED 光刻胶（应用于两膜层）及晶圆制造 i 线正性光刻胶已分别通过京东方及华虹宏力的认证并开始小批量供应。公司光刻胶配套试剂主要应用于先进封装领域。公司是国内先进封装光刻胶配套试剂产品主力供应商，主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

**问题三：您好，公司一季度归母净利润大幅上升，主要原因是什么？**

回答：公司 2024 年一季度归母净利润同比增长 112.28%，主要系公司营业收入的增长、政府补助及资金管理收益的增长所致。

**问题四：公司其他电子化学品包括哪些？**

回答：其他电子化学品主要为感光油墨，主要用于 PCB 电子线路板自动

	<p>化生产制造中的文字喷墨打印等。</p> <p><b>问题五：公司研发投入在哪些产品和领域？</b></p> <p>回答：公司研发主要投入在先进封装及晶圆制造领域电镀液和光刻胶等产品，研发费用主要包括研发人员薪酬、研发耗材、仪器设备折旧等。</p> <p>主要产品包括：晶圆制造 14nm 制程超纯硫酸钴、28nm 制程大马士革电镀铜添加剂、功率器件用 PSPI 光刻胶；先进封装用电镀铜添加剂、电镀锡银添加剂等。</p> <p><b>问题六：境外销售哪些产品？</b></p> <p>回答：公司境外销售产品主要是电镀液及配套试剂，外销业务的客户主要为国内出口加工区、保税区内半导体封装制造企业。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 30 日